**证券代码：688521 证券简称：芯原股份**

**芯原微电子（上海）股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | □ 特定对象调研 □ 分析师会议□ 媒体采访 √ 业绩说明会□ 新闻发布会 □ 路演活动□ 现场参观 √ 电话会议□ 其他（ ）  |
| **参与单位名称** | 2024年3月31日博时基金、淡水泉投资、华安基金、嘉实基金、建信基金、景林资产、长城基金、中银基金等2024年4月1日公开业绩说明会 |
| **时间** | 2024年3月31日、2024年4月1日 |
| **调研方式** | 线上会议 |
| **公司接待人员姓名** | 公司董事长兼总裁：WAYNE WEI-MING DAI（戴伟民）公司董事、CFO、董事会秘书：施文茜 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** |
| **公司介绍** | 芯原股份是一家依托自主半导体IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。公司至今已拥有高清视频、高清音频及语音、车载娱乐系统处理器、视频监控、物联网连接、数据中心等多种一站式芯片定制解决方案，以及自主可控的图形处理器IP、神经网络处理器IP、视频处理器IP、数字信号处理器IP、图像信号处理器IP和显示处理器IP共六类处理器IP、1,500多个数模混合IP和射频IP。主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括IDM、芯片设计公司，以及系统厂商、大型互联网公司等。芯原在传统CMOS、先进FinFET和FD-SOI等全球主流半导体工艺节点上都具有优秀的设计能力。在先进半导体工艺节点方面，公司已拥有14nm/10nm/7nm FinFET和28nm/22nm FD-SOI工艺节点芯片的成功流片经验，目前已实现5nm系统芯片（SoC）一次流片成功，多个5nm一站式服务项目正在执行。此外，根据IPnest在2022年的统计，从半导体IP销售收入角度，芯原是中国排名第一、全球排名第七的半导体IP授权服务提供商，在全球排名前七的企业中，芯原的IP种类排名前二。2023年，在全球经济起伏、国际形势复杂的大背景下，半导体行业周期波动明显。公司在2023年上半年保持盈利趋势，在2023年全年实现营业收入23.38亿元。公司目前在手订单充足，截至2023年末，公司在手订单金额20.61亿元，其中一年内转化的在手订单金额18.07亿元，占比近90%。 |
| **交流问答** | **问题：请问公司境内外收入占比情况如何？** 回复：近年来，国内市场对于半导体IP和芯片的需求较为旺盛，公司境内销售收入提升较快，在2023年度，公司境内销售收入18.07亿元，同比增长3.85%，占营业收入比重为77.28%，较去年同期的64.94%大幅提升；受到海外宏观经济等因素影响，公司境外销售收入5.31亿元，同比有所下滑，境外收入占整体营业收入比重为22.72%。根据目前订单情况，在2024年，公司海外客户需求有所恢复。公司始终重视扩充海内外客户资源，关注全球市场机遇，实现境内外业务同步发展。**问题：请问公司如何看待AI PC跟AI手机今年的增长，相关需求对公司产品服务是否有带动？** 回复：随着边缘人工智能应用快速发展，公司不断优化升级相关IP技术，提升公司自身的竞争力和市场地位。目前，集成了芯原神经网络处理器（NPU）IP的人工智能（AI）类芯片已在全球范围内出货超过1亿颗，主要应用于包含智能手机、平板电脑、可穿戴设备等在内的10多个市场领域。为应对手机、电脑对AI算力持续增长的需求，公司一直以来持续优化和升级公司的NPU IP，并推出了一系列创新的AI-ISP、AI-GPU等基于公司NPU技术的IP子系统，给传统的处理器技术带来颠覆性的性能提升，为各类终端电子产品提供多维度、高效率的人工智能升级。公司始终关注市场趋势和技术发展动向，积极推进新技术的研发，持续强化研发实力，保持技术先进性及核心竞争力。**问题：请问公司在机器视觉上有哪些技术储备和业务进展？** 回复：公司的神经网络处理器（NPU）IP适用于机器视觉领域。目前，集成了芯原NPU IP的人工智能（AI）类芯片已在全球范围内出货超过1亿颗，主要应用于物联网、可穿戴设备、智慧电视、智慧家居、安防监控、服务器、汽车电子、智能手机、平板电脑、智慧医疗等10个市场领域。在过去七年里，公司在嵌入式AI/NPU领域全球领先，其NPU IP已被72家客户用于上述市场领域的128款AI芯片中。根据目前市场的需求，芯原基于自身NPU IP可伸缩可扩展的特性，已发展了覆盖从高性能云计算到低功耗边缘计算的垂直解决方案。公司基于自研的NPU IP和其他丰富的处理器IP储备，还推出了一系列创新的AI-ISP、AI-GPU等子系统，以应对人工智能不断发展的应用需求。此外，公司正在继续开发针对图像、机器视觉及先进无线通讯应用的矢量DSP IP产品，包括针对不同级别性能要求的内核产品的开发和优化，业界通用嵌入式机器视觉库OpenCV、OpenVx等的开发和优化工作等。**问题：请问公司定增融资有何最新进展，目前是否有计划使用自有资金或银行贷款等形式进行前期研发投入？**回复：公司已于2024年2月2日收到了上交所出具的《关于受理芯原微电子（上海）股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》，于2024 年 3 月21日收到上交所出具的《关于芯原微电子（上海）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》，目前正在筹备问询回复。公司目前经营稳健、现金流情况良好，公司会正常推进日常经营并基于公司战略进行研发布局。 |